

國立清華大學

碩士論文

題目：以氫電漿處理方法對金膜與自生氧化
層矽基材附著力改善之研究

The improvement of Au film and SiO_x/Si substrate
adhesion using H₂ plasma treatment

系 所：動力機械工程所 組 別：固力組

學 號：g933781

姓 名：林正裕 (Cheng-Yu Lin)

指導教授：葉銘泉 博士 (Dr. Ming-Chuen Yip)

方維倫 博士 (Dr. Weileun Fang)

中華民國九十五年六月